

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
26. Mai 2005 (26.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/048358 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 33/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/012438

(22) Internationales Anmeldedatum:  
3. November 2004 (03.11.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
103 51 934.3 7. November 2003 (07.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **TRIDONIC OPTOELECTRONICS GMBH**  
[AT/AT]; Technologiepark 10, A-8380 Jennersdorf (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **TASCH, Stefan**

[AT/AT]; Angerstrasse 33, A-8380 Jennersdorf (AT).  
**HOSCHOPF, Hans** [AT/AT]; Hans Ponstingl Gasse 21,  
A-8380 Jennersdorf (AT).

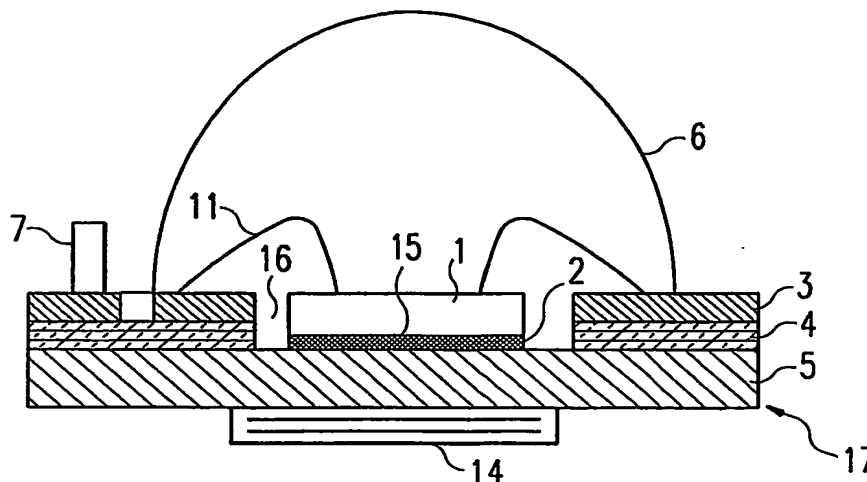
(74) Anwalt: **RUPP, Christian**; Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33, Postfach 33 06 09, 80066 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: LIGHT-EMITTING DIODE ARRANGEMENT COMPRISING A HEAT-DISSIPATING PLATE

(54) Bezeichnung: LEUCHTDIODEN-ANORDNUNG MIT WÄRMEABFÜHRENDER PLATINE



(57) Abstract: The invention relates to a light-emitting diode arrangement comprising at least one light-emitting diode chip (1), a multi-layer plate (17) provided with a base (5) consisting of a material exhibiting good thermal conductivity and especially consisting of metal, and an electrically insulating and thermoconductive joining layer (2) between the emission surface of the light-emitting diode chip (1) and the plate (17).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend: - wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1), - eine Mehrschicht-Platine (17) mit einer Basis (5) aus einem thermisch gut leitfähigen Material, insbesondere aus Metall, und - eine elektrisch isolierende und thermisch leitende Verbindungsschicht (2) zwischen der Emissionsfläche des Leuchtdioden-Chips (1) und der Platine (17).

WO 2005/048358 A1



(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht